

使用用途別 早わかりフローチャート



ご使用の前には、必ず製品の添付文書及び取扱説明書に記載の
使用方法・注意事項をお読みください。

目次

直接充填

- 1** 光重合型コンポジットレジンの充填 P3,4

セメント接着

- 2** CAD/CAMレジン冠のセメント接着 P5,6
3 ジルコニアクラウンのセメント接着 P7,8
4 インプラントアバットメントへの補綴装置の接着 P9,10
5 金属冠、前装冠のセメント接着 P11

支台築造

- 6** ファイバーポストを用いた支台築造 - 直接法 P12
7 金属ポストを用いた支台築造 - 直接法 P13
8 ファイバーポストを用いたデュアルキュア型/
セルフキュア型 支台築造材料による支台築造 - 直接法 ... P14,15
9 ファイバーポストを用いた支台築造 - 間接法① コアの作成 ... P16
10 支台築造 - 間接法② レジンコアのセメント接着 ... P17,18,19
11 セメントによるファイバーポストの植立 P20,21

リペア

- 12** 口腔内リペア 前装冠の破折（歯質を含む場合） P22
13 口腔内リペア 前装冠の破折（歯質を含まない場合） P23

その他

- 14** 窩洞シーリング P24
15 知覚過敏の処置 P25

製品別索引

	直接充填	セメント接着	支台築造	リペア	その他
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」	P4	P6,8	P12,13,15,18	P22	P24,25
「クリアフィル® メガボンド® 2」	P3		P14		
「SA ルーティング® プラス」		P6,8,10,11	P18,19,21		
「パナピア® V5」		P5,7,9	P17,20		

○照射器の分類と光量の関係について、特に記載のない場合は以下の表を参照ください。

分類	光量
高出力LED照射器	1500mW/cm ² 以上
LED照射器	800～1400mW/cm ²
ハロゲン照射器	400mW/cm ² 以上

光量について使用する各照射器の添付文書をご確認ください。

「クリアフィル」、「メガボンド」、「マジェスティ」、「SAルーティング」、「パナピア」、「オートミックス」は株式会社クラレの登録商標です。



「クリアフィル®
メガボンド® 2」

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエステクニク)が有効です。



2 プライマー塗布

20秒間処理



3 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥



4 ボンド塗布



5 マイルドなエアブローで均一に



6 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

7 光重合型CRの処理^{※1}



POINT

※1 ご使用の光重合型CRの添付文書をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® メガボンド® 2」添付文書記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」を示します。

1-2 光重合型コンポジットレジン^{※1}の充填



「クリアフィル[®]
ユニバーサルボンド Quick」

直接
充填

1 窩洞形成・防湿・歯髄保護・ 充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液
(カリエステクター)が有効です。



2 ボンド塗布

待ち時間なしで **3** へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥^{※1}

5秒以上乾燥



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

5 光重合型CRの処理^{※2}



POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの添付文書をご参照ください。

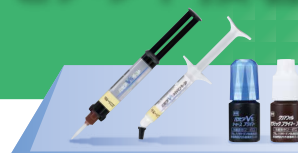
本術式は「クリアフィル[®] ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「光重合型の歯科充填用コンポジットレジンによる充填修復」を示します。

2-1

CAD/CAMレジン冠のセメント接着



通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



「パナビア® V5」

1 試適後、サンドブラスト処理※1。 超音波洗浄・乾燥



2 K エッチャント シリンジ 塗布 5秒後水洗・乾燥



3 シラン処理（「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」 塗布）・エアブローで乾燥



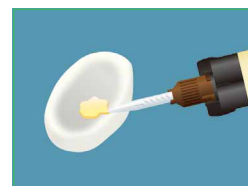
4 トゥース プライマー 塗布、 20秒処理後エアブローで乾燥※2



5 クラウンまたは窩洞内に ペースト塗布

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	60秒



6 装着・余剰セメントの除去

光照射で半硬化させる除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき3～5秒光照射



② 探針等で除去



小筆による除去法

① 余剰セメントを小筆等で除去



② マージン部に光照射



光照射については下記表をご参照ください。

7 最終硬化 (3分保持) ※3



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 支台歯(歯質、レジンコア、メタルコア)の一括処理が可能です。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただし、オペークは光照射での最終硬化は行えません。

本術式は「パナビア® V5」添付文書記載の「クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

2-2

CAD/CAMレジン冠のセメント接着

「SA ルーティング® プラス」を使用してより高い接着を求める場合



通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「SA ルーティング®
プラス」

1

試適後、
サンドブラスト処理※1
超音波洗浄・乾燥



2

リン酸処理
5秒後水洗・乾燥



3

シラン処理（「クリアフィル®
セラミック プライマー
プラス」塗布）・
エアブローで乾燥



4

ボンド塗布



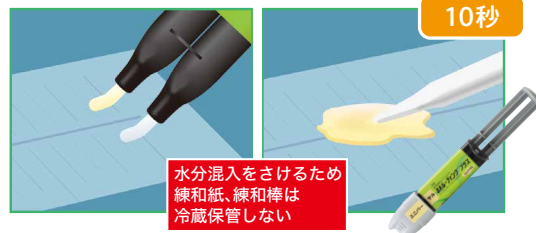
5

乾燥
マイルドなエアブロー
で5秒以上乾燥※2



6

AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



7

クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	40秒



8

装着・余剰
セメントの除去※3

1か所につき
1~2秒光照射



9

最終硬化
(5分保持) ※4



セメント接着

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。
- ※3 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。
- ※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「セメント接着における補綴修復物の処理」「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」、及び「SA ルーティング® プラス」添付文書記載の「金属、シリコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

3-1

ジルコニアクラウンのセメント接着

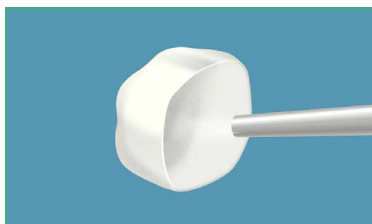


通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

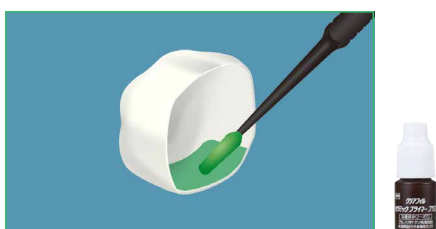


「パナピア® V5」

1 試適後、サンドブラスト処理※1 超音波洗浄・乾燥



2 「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」塗布・エアブローで乾燥



3 トゥース プライマー塗布※2、20秒処理後エアブローで乾燥



4 クラウンまたは窩洞内にペースト塗布

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	60秒



5 装着・余剰セメントの除去

光照射で半硬化させる除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき3～5秒光照射



② 探針等で除去



小筆による除去法

① 余剰セメントを小筆等で除去



② マージン部に光照射



光照射については下記表をご参照ください。

6 最終硬化(3分保持) ※3



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.2を参照ください。

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 支台歯(歯質、レジンコア、メタルコア)の一括処理が可能です。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただし、オペークは光照射での最終硬化は行えません。

本術式は「パナピア® V5」添付文書記載の「クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

3-2

ジルコニアクラウンのセメント接着

「SA ルーティング® プラス」を使用してより高い接着を求める場合



通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「SA ルーティング®
プラス」

1 試適後、サンドブラスト処理※1 超音波洗浄・乾燥



2 ボンド塗布

待ち時間なしで 3へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



4 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和

10秒



水分混入をさけるため
練和紙、練和棒は
冷蔵保管しない

5 クラウンまたは 窩洞内にペースト塗布

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内 に塗布した場合の 操作時間 (37℃)	40秒

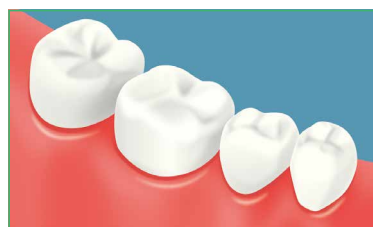


6 装着・余剰セメントの除去※3



1か所につき1～2秒光照射

7 最終硬化(5分保持)※4



セメント
接着

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。
- ※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。
- ※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

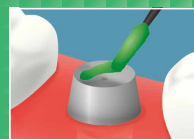
分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

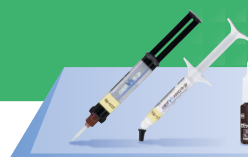
本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「セメント接着における窩洞、及び支台歯の処理」及び「SA ルーティング® プラス」添付文書記載の「金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

4-1

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着

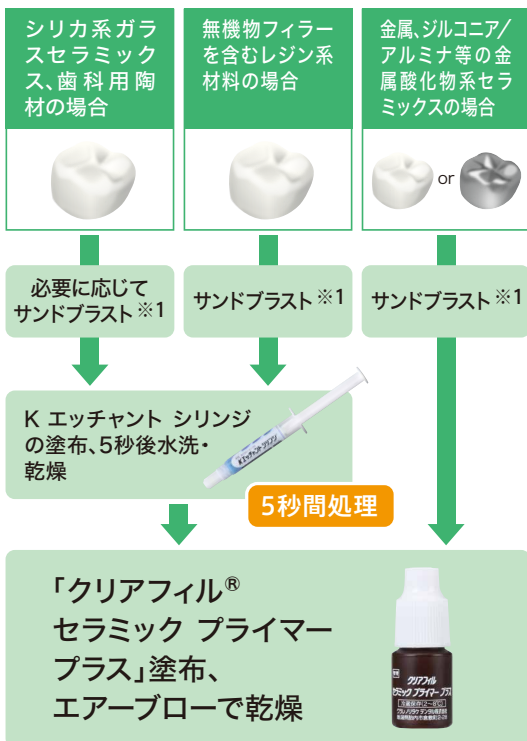


通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・
支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



「パナピア® V5」

1 補綴装置の処理



2 アバットメントへの「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」塗布・マイルドなエアブローで乾燥



3 補綴装置へのペースト塗布

操作時間

操作時間 (23℃) 2分



4 装着、余剰セメント除去

光照射で半硬化させる除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき3～5秒光照射



② 探針等で除去



小筆による除去法

① 余剰セメントを小筆等で除去



② マージン部に光照射



又は

光照射については照射器と照射時間の関係をご参照ください。

5 最終硬化※2

保持時間

37℃	5分
23℃	10分



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。

※2 光を透過する補綴装置の場合はマージン部を含む補綴装置全体への光照射（照射器と照射時間の関係参照）による最終硬化も可能です。ただしオペークは光照射での最終硬化は行えません。

照射器と照射時間の関係

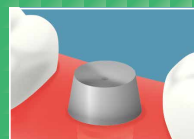
分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「パナピア® V5」添付文書記載の「インプラントアバットメント又はフレーム上への補綴物の接着」を示します。

4-2

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着



通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

「SA ルーティング®
プラス」

1 補綴装置の処理

シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

リン酸処理5秒
後水洗、乾燥

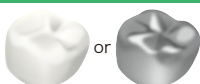


5秒間処理

シラン処理(「クリアフィル®
セラミックプライマー プラス」)
塗布、エアブローで乾燥



金属、ジルコニア/アルミナ
等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含む
レジン系材料の場合



サンドブラスト※1

2 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和



10秒

水分混入をさけるため
練和紙、練和棒は
冷蔵保管しない

3 補綴装置へのペースト塗布



操作時間

操作時間(23℃) 2分

4 補綴装置の装着



5 余剰セメントの除去※2



1か所につき2～5秒光照射

6 最終硬化(5分保持)※3



セメント
接着

POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合補綴装置全体及びマージン部への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

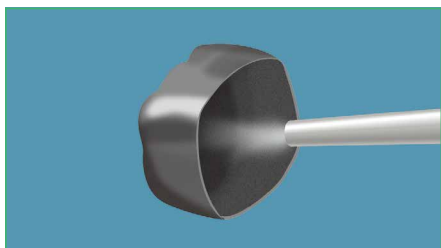
本術式は「SA ルーティング® プラス」添付文書記載の「インプラントアバットメント又はフレーム上への金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製された補綴物の接着」を示します。



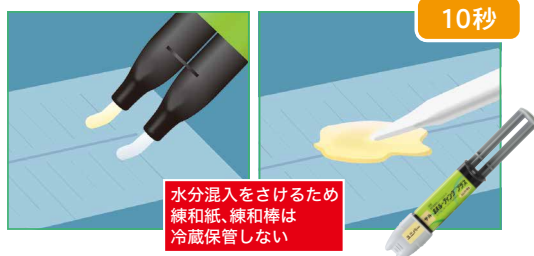
通法にしたがい仮封材・仮着材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。

「SA ルーティング® プラス」

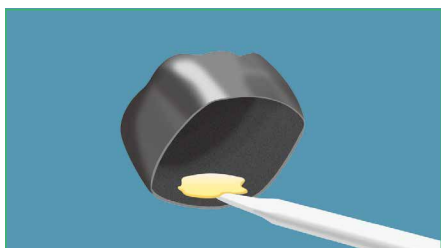
1 試適後、サンドブラスト処理※1 超音波洗浄・乾燥



2 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和



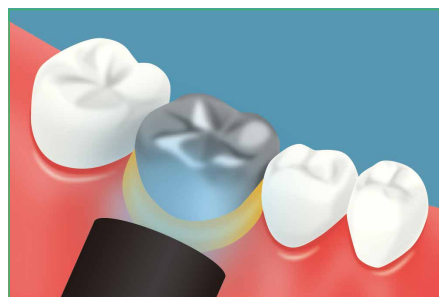
3 クラウンまたは 窩洞内にペースト塗布



操作時間

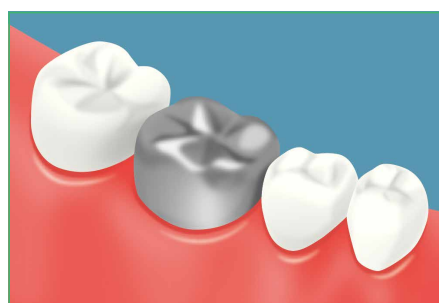
操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	40秒

4 装着・余剰セメントの除去※2



1か所につき2～5秒光照射

5 最終硬化(5分保持)※3



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。
- ※3 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

本術式は「SA ルーティング® プラス」添付文書記載の「金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックス、無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材で作製したクラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着」を示します。

ファイバーポストを用いた支台築造 - 直接法



通法にしたい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE」

1 ポストの表面処理



2 ボンド塗布



3 マイルドなエアブローで5秒以上乾燥 ※1



4 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

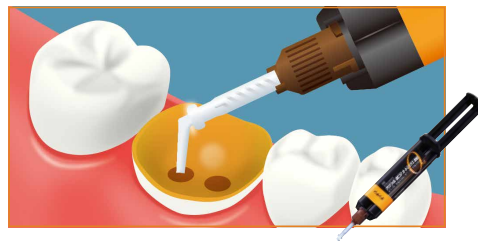
分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)



5 ペーストの填入 ※2



6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)」参照

7 ペーストの築盛・光照射 ※3,4. 支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

- ※1 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※2 ポストの植立は1分以内に行ってください。
- ※3 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。
- ※4 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

金属ポストを用いた支台築造 - 直接法



通法にしたい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE」

1 ポストの表面処理

サンドブラスト※1
ボンド塗布・エア
ブローで乾燥

ボンド塗布・乾燥



2 ボンド塗布

待ち時間なしで 3へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



4 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

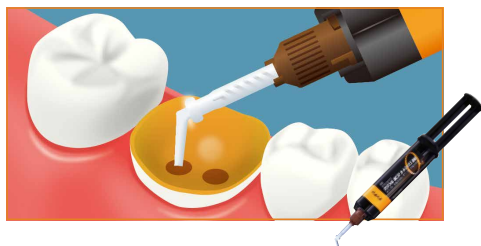
分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。



「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

5 ペーストの填入※3



6 ポスト植立・光照射



「ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）」参照

7 ペーストの築盛・光照射※4,5 支台歯形成



ペーストへの照射時間と硬化深度の関係（歯科重合用光照射）

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

POINT

※1 「AD ポストII」はサンドブラスト処理不要です。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。

※3 ポストの植立は1分以内に行ってください。

※4 舌側と唇側の2方向より所定時間光照射してください。

※5 光硬化深度以上に築盛する場合は光照射後6分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「歯科用ポストの表面処理」「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるポストの植立及び/又は支台築造」及び「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」添付文書記載の「直接法による支台築造」を示します。

8-1

ファイバーポストを用いたデュアルキュア型/ セルフキュア型支台築造材料による支台築造 - 直接法



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



「クリアフィル®
メガボンド® 2」



「クリアフィル®
ボーセレンボンド
アクティベーター」



「クリアフィル®
DCアクティベーター」

「クリアフィル® メガボンド® 2」は「クリアフィル® DCアクティベーター」と混和し、デュアルキュア型/セルフキュア型支台築造材料の接着に使用できます。

1 ポストの表面処理

① リン酸処理
水洗・乾燥

5秒間処理



例えば

② プライマーと「クリア
フィル® ボーセレンボ
ンドアクティベーター」
の混和液※1塗布・エ
アブローで乾燥



2 プライマー塗布、乾燥

20秒処理後、マイルドなエアブロー
で5秒以上乾燥※2

20秒処理後 → 5秒以上乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® DCアクティベーター」の 混和液※1塗布



4 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2,3

5秒以上乾燥



5 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。



「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒（製造販売元：株式会社 モリタ製作所）

6 ポスト植立及び/又は支台築造 ※4



支
台
築
造

POINT

※1 1滴ずつ等量混和してください。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。

※3 根管内に残った余剰液はペーパーポイント等で吸い取り、再度エアブローで乾燥してください。

※4 使用する材料の添付文書をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® メガボンド® 2」添付文書記載の「歯冠修復物及び歯科用ポストの表面処理」、「デュアルキュア型又はセルフキュア型の支台築造材料によるポストの植立及び/又は支台築造」、及び「クリアフィル® DCアクティベーター」添付文書記載の「デュアルキュア型又はセルフキュア型の支台築造材料を用いたポストの植立/又は支台築造」を示します。

8-2

ファイバーポストを用いたデュアルキュア型/ セルフキュア型支台築造材料による支台築造 - 直接法



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「クリアフィル®
DCアクティベーター」

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」は「クリアフィル® DCアクティベーター」と混和し、デュアルキュア型/セルフキュア型支台築造材料の接着に使用できます。

1 ポストの表面処理



2 ボンド、「クリアフィル® DCアクティベーター」の混和液※¹ 塗布



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※²

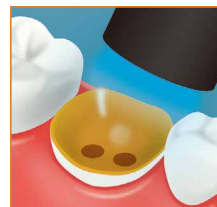


4 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.2を参照ください。



「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元: 株式会社 モリタ製作所)

5 ペーストの等量採取・練和※³



6 ポスト植立及び/又は支台築造※³



POINT

※¹ 1滴ずつ等量混和してください。

※² バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰液はペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。

※³ 使用する材料の添付文書をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「デュアルキュア型又はセルフキュア型の歯科用支台築造材料によるポストの植立及び/又は支台築造」、及び「クリアフィル® DCアクティベーター」添付文書記載の「デュアルキュア型又はセルフキュア型の支台築造材料を用いたポストの植立/又は支台築造」を示します。

ファイバーポストを用いた 支台築造 - 間接法① コアの作成



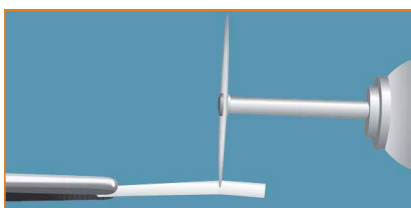
通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、
築造窩洞の形成、印象採得等を行ってください。

「クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE」

1 模型を製作



2 ポストの試適、切断、清掃



3 ポストの表面処理

① リン酸処理
5秒後、水洗・乾燥

5秒間処理

例えば

② シラン処理(「クリアフィ
ル® セラミック プライ
マー プラス」)塗布・エ
アブローで乾燥

4 分離材を塗布



5 ペーストの填入



6 ポスト植立・光照射



光照射については下記表をご参照ください。

7 ペースト築盛



操作可能時間
(23℃遮光下)

ミキシングチップを通して
練和開始後3分

8 光照射※1・支台歯形成



光照射については下記表をご参照ください。

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm
ハロゲン 照射器	ハロゲン ランプ	300mW/cm ² 以上	10秒	1.5mm
			20秒	2.0mm

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	照射時間	硬化深度
アルファライトⅡ ¹⁾	120秒	3.0mm
アルファライトⅡIN ¹⁾		5.0mm
アルファライトⅢ ¹⁾	180秒	

1) 製造販売元: 株式会社モリタ 東京製作所

POINT

※1 光硬化深度以上に築盛する場合は10分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」添付文書記載の「間接法による支台築造」を示します。

支台築造 - 間接法②

レジンコアのセメント接着



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。



「パナビア® V5」

1 レジンコアの表面処理

① サンドブラスト処理※1、超音波洗浄・乾燥

② K エッチャントシリンジ塗布、5秒後水洗・乾燥

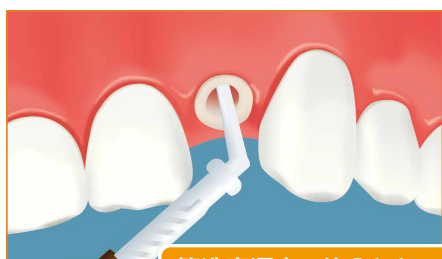
5秒間処理

③ シラン処理(「クリアフィル®セラミックプライマー プラス」)塗布 エアブローで乾燥

2 トゥース プライマー塗布 20秒処理後乾燥※2



3 コアの被着面または築造窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した場合は60秒以内に **④**へ

4 レジンコアの装着※3、余剰セメント除去

光照射で半硬化させる除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき3～5秒光照射

3～5秒

② 探針等で除去

小筆による除去法

余剰セメントを小筆等で除去

又は

5 マージン部に光照射※4



オパークの場合はさらに3分保持

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台歯形成

6分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 余剰のプライマーをペーパーポイント等で吸い取った後、エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 1回の光照射で、光硬化させる部位全てが照射径に入らない場合は、光照射を繰り返して全ての部位に対して光照射を行ってください。

本術式は「パナビア® V5」添付文書記載の「コア、ポストの接着」を示します。



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、
築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」



「SA ルーティング®
プラス」

1 レジンコアの表面処理

サンドブラスト処理※1
超音波洗浄・乾燥



2 ボンド塗布

待ち時間なしで [3] へ



3 乾燥

マイルドなエアークローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



4 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和

10秒



水分混入をさけるため
練和紙、練和棒は
冷蔵保管しない

5 ペースト填入・コアの装着

CRシリンジ等で築造窩洞内にペースト填入
その後コアを挿入※3



6 余剰セメント除去※4



1か所につき1~2秒光照射

7 マージン部に光照射

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力 LED照射器	(3秒又は5秒) ×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.2を参照ください。



8 支台歯形成

10分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 化学硬化により除去する際は2~4分保持してください。



「SA ルーティング®
プラス」

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、
築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。

1 レジンコアの表面処理

サンドブラスト処理 ※1
超音波洗浄・乾燥



2 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和



水分混入をさけるため
練和紙、練和棒は
冷蔵保管しない

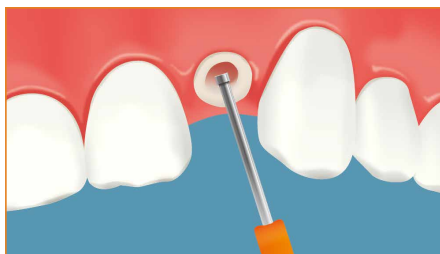
操作時間

操作時間 (23°C)

2分

3 ペースト填入・コアの装着

CRシリンジ等で築造窩洞内にペースト填入
その後コアを挿入 ※2



4 余剰セメント除去 ※3



1か所につき2～5秒光照射

5 マージン部に光照射 ※4

残存歯冠に光照射



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台歯形成

10分保持し形成



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の添付文書にしたがってください。

※2 気泡の混入にご注意ください。

※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※4 1回の光照射で、光硬化させる部位全てが照射径に入らない場合は、光照射を繰り返して全ての部位に対して光照射を行ってください。

セメントによる ファイバーポスの植立



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポスの試適、切断等を行ってください。



「パナビア® V5」

1 ポスの表面処理

① K エッチャント シリンジ塗布・5秒後
水洗い乾燥

5秒間処理

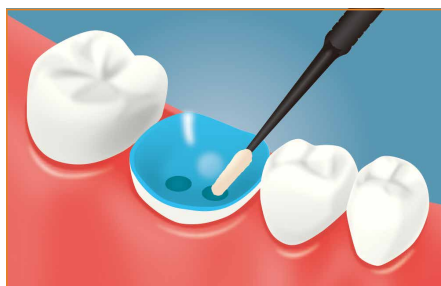
② シラン処理(「クリアフィ
ル® セラミック プライ
マー プラス」)塗布・エ
アブローで乾燥

2 トゥース プライマーの 塗布・20秒間処理



20秒

3 余剰プライマーの除去・ エアブローで乾燥 ※1



4 ペーストの塗布、ポスの挿入 ※2,3

操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の 操作時間 (37℃)	60秒



5 光照射 ※4



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

6 支台築造材料による支台築造・ 支台歯形成 ※5,6



支台築造

POINT

- ※1 余剰プライマーはペーパーポイント等で吸い取った後、バキュームで吸引しながら乾燥してください。
- ※2 気泡の混入にご注意ください。
- ※3 余剰ペーストは残存歯冠、ポスのヘッド部に広げてください。
- ※4 オペークの場合は3分間保持してください。
- ※5 支台歯形成は植立から6分以上経過した後に行ってください。
- ※6 使用する材料の添付文書を参照ください。

セメントによる ファイバーポスの植立



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポスの試適、切断等を行ってください。

「SA ルーティング®
プラス」

1 AペーストBペースト 等量採取・10秒練和・ ポストにペースト塗布



操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布した場合の操作時間 (37℃)	40秒

2 ポスト挿入 ※1,2



3 光照射 ※3



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

4 支台築造材料による支台築造・ 支台歯形成 ※4,5



POINT

- ※1 気泡の混入にご注意ください。
- ※2 余剰ペーストは残存歯冠、ポストのヘッド部に広げてください。
- ※3 残存歯冠やポストのヘッド部に対して各面につき光照射してください。
- ※4 支台歯形成は植立から10分以上経過した後に行ってください。
- ※5 使用する材料の添付文書を参照ください。

口腔内リペア 前装冠の破折

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)

【歯質を含む場合】



「クリアフィル®
ポーセレンボンド
アクティベーター」



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 リン酸処理、5秒後水洗、乾燥



3 ボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」 の混和液※1,2 塗布



4 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※3

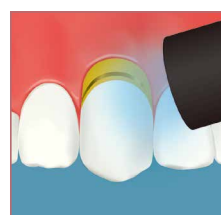


5 光照射

ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。



「ベンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

6 光重合型CRの充填、光照射、研磨※4

メタル部のマスキングには「クリアフィル®
ST オベーカー」をご使用ください。



POINT

- ※1 粗造化が困難な貴金属面に対しては、「アロイ プライマー」を添付文書にしたがい塗布、乾燥した後にボンドと「クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター」の混和液を塗布してください。
- ※2 1滴ずつ等量混和してください。
- ※3 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。
- ※4 ご使用の色調遮蔽材料、光重合型CRの添付文書をご参照ください。

口腔内リペア 前装冠の破折

(例えば、金属・陶材・コンポジットレジン)

【歯質を含まない場合】



「クリアフィル®
ST オペーカ―」

1 被着面の粗造化、水洗、乾燥



2 被着面の処理※



3 金属面に「クリアフィル® ST オペーカ―」を塗布 (0.5 mm以下) 光照射 (下記表参照) その後、光重合型CRの処理※



「クリアフィル® ST オペーカ―」の照射時間

歯科用可視光線照射器	光量	材料の厚さ (mm)	
		～0.4	0.4～0.5
従来型ハロゲン照射器	150～550mW/cm ²	40秒	60秒
高出力ハロゲン照射器	550mW/cm ² 以上	10秒	20秒
プラズマーク照射器	2000mW/cm ² 以上 (400～515 nm) 且つ 450mW/cm ² 以上 (400～435 nm)	5秒	5秒
LED照射器	120mW/cm ² 以上	40秒	80秒

POINT

※ 使用する材料の添付文書をご参照ください。

本術式は「クリアフィル® ST オペーカ―」添付文書記載の「前装冠の補修(破折した前装冠の補修時における金属色の遮蔽)(歯肉の退縮した前装冠補修時の歯根色と金属色の遮蔽)」を示します。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」

1 窩洞形成・防湿・ 歯髄保護・充填準備

感染象牙質の除去のためにう蝕検知液(カリエステクター)が有効です。



2 ボンド塗布

待ち時間なしで **3** へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※1

5秒以上乾燥



4 光照射



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

5 低粘度の光重合型CRの処理※2



その他

POINT

※1 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。

※2 ご使用の光重合型CRの添付文書をご参照ください。



「クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick」

1 患部の診察・歯面清掃・防湿 患部全体にボンド塗布

待ち時間なしで **2** へ



2 乾燥(弱～中圧)

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※

5秒以上乾燥



3 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、
標準モードは10秒(製造販売元:株式会社 モリタ製作所)

4 未重合層の除去



POINT

※ バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

本術式は「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」添付文書記載の「知覚過敏の処置」を示します。

■ ボンディング材

管理医療機器 歯科用象牙質接着材
(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick

医療機器認証番号:228ABBZX00065000

【単品】



管理医療機器 歯科用象牙質接着材
(歯科セラミックス用接着材料)(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)

クリアフィル® メガボンド 2

医療機器認証番号:227ABBZX00114000

【セット】



■ セメント

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

医療機器認証番号:226ABBZX00106000

【スターターキット】ユニバーサル



管理医療機器 歯科接着用レジンセメント

SA ルーティング® プラス

医療機器認証番号:226ABBZX00011000

【バリューキット】ユニバーサル

【単品】ユニバーサル/ホワイト/トランスルーセント



コンボジットレジン

管理医療機器 歯科充填用コンボジットレジン

クリアフィル®マジィスティ® ESフロー

医療機器認証番号: 224ABBZX00170000

【単品】 Super Low / Low / High



管理医療機器 歯科充填用コンボジットレジン

クリアフィル®マジィスティ® ES-2

医療機器認証番号: 224ABBZX00119000

【単品】



管理医療機器 歯科接着用レジセメント

SA セメントプラスオートミックス®

医療機器認証番号: 225ABBZX00142000

【単品】 ユニバーサル/ホワイト/トランスルーセント

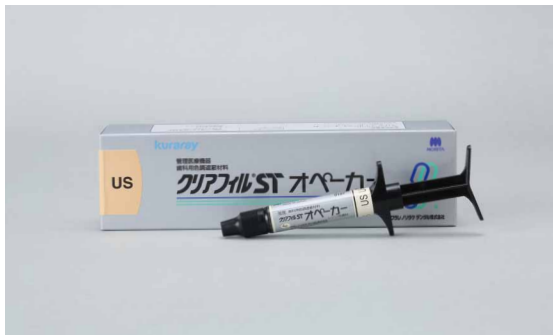


管理医療機器 歯科用色調遮蔽材料

クリアフィル® ST オペーカー

医療機器承認番号: 16200BZZ00980000

【単品】



支台築造

管理医療機器 歯科用支台築造材料

クリアフィル® DCコア オートミックス ONE

医療機器認証番号: 223ABBZX00086000

【単品】デンチン/ホワイト



管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品

クリアフィル® AD ファイバーポスト

医療機器認証番号: 228ABBZX00058000

【単品】



診療材料

管理医療機器 歯科用象牙質接着材

クリアフィル® DCアクティベーター

医療機器認証番号: 228ABBZX00066000

【単品】



管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号: 226ABBZX00089000

【単品】



管理医療機器 歯科根管用ポスト成形品

ADポスト II

医療機器承認番号:20600BZZ01004000

【フルサイズセット】

【単品】



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)(歯科用象牙質接着材)(歯面処理材)

クリアフィル® ポーセレンボンド アクティベーター

医療機器承認番号:16300BZZ00085000

【単品】



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)

クリアフィル® セラミックプライマー プラス

医療機器認証番号:226ABBZX00105000

【単品】





●ご使用に際しましては製品の添付文書を必ずお読みください。



製品・各種技術
に関する
お問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル



0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 (大手センタービル)
フリーダイヤル: 0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15
お客様相談センター: 0800-222-8020
<http://www.dental-plaza.com>

TEL (06) 6380-2525
TEL (03) 3834-6161